

Заместитель министра промышленности и торговли РФ В. В. Шпак дал интервью «РИА Новости»

В начале ноября информационное агентство «РИА Новости» опубликовало интервью с Василием Викторовичем Шпаком. В беседе с Наталией Мирошниченко и Маргаритой Матяшевой замглавы Минпромторга России рассказал о разработке российского оборудования для производства микроэлектроники, планах создания полигонов для его тестирования, мерах поддержки отрасли, а также ответил на другие вопросы, касающиеся развития отечественной микроэлектронной промышленности.



Отвечая на вопрос про приоритетность для отрасли развития собственных компетенций в процессах производства чипов, заместитель министра отметил, что существует понимание необходимости своей технологии, которая позволяла бы сохранять способность к выпуску микроэлектронных изделий при

любых внешних обстоятельствах, причем это понимают и в других странах. По его словам, если нет суверенной микроэлектроники, то нет технологического суверенитета.

Говоря о планах развития отечественного оборудования для микроэлектронных производств, В. В. Шпак сообщил, что производство российского литографа для технологии 350 нм начнется уже в следующем году, а оборудования для выпуска чипов с нормами 130 нм – в 2026 году. Далее планируется двигаться в сторону самых современных топологических норм. «Мы сейчас встали на этот путь, причем не одни, а вместе с белорусами. Китай в этом направлении тоже идет. Началась гонка», – сказал заместитель министра.

О полигонах для тестирования отечественного оборудования для производства микроэлектронных изделий было сказано, в частности, что на данный момент Департаментом станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России готовится соответствующая

концепция, а создание самих полигонов будет запущено в следующем году. При этом окончательное решение о том, каким будет старт этого проекта, будет принято во втором квартале 2024 года.

Свой ответ на вопрос о мерах поддержки В. В. Шпак начал со слов: «На наш взгляд, меры поддержки отрасли уже сформированы». Он отметил, что в определенной степени они требуют точечной донастройки, но в целом на всех этапах создания изделия поддержка оказывается – как непосредственно Минпромторгом России, так и рядом институтов развития. «Если мы поймем, что нужна еще какая-то мера поддержки, то будем оперативно вносить соответствующие изменения. На сегодняшний момент, наверное, требует еще донастройки история, связанная со стимулированием внедрения отечественных решений: льготные кредиты и льготный лизинг. Сейчас изучаем этот вопрос», – сказал он.

В ответе на вопрос про финансирование развития электроники была приведена информация, что в рамках ряда государственных программ на 2024 год заложено 211,4 млрд руб.

Также В. В. Шпак ответил на вопросы о востребованности чипов с различными проектными нормами, применении российских чипов в банковских картах и заграничных паспортах, разработках в сфере микроэлектроники для БПЛА и др.

Прочитать интервью можно на сайте «РИА Новости», пройдя по ссылке <https://ria.ru/20231101/shpak-1906499130.html> или воспользовавшись QR-кодом справа.

